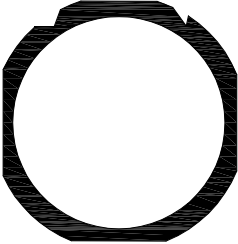

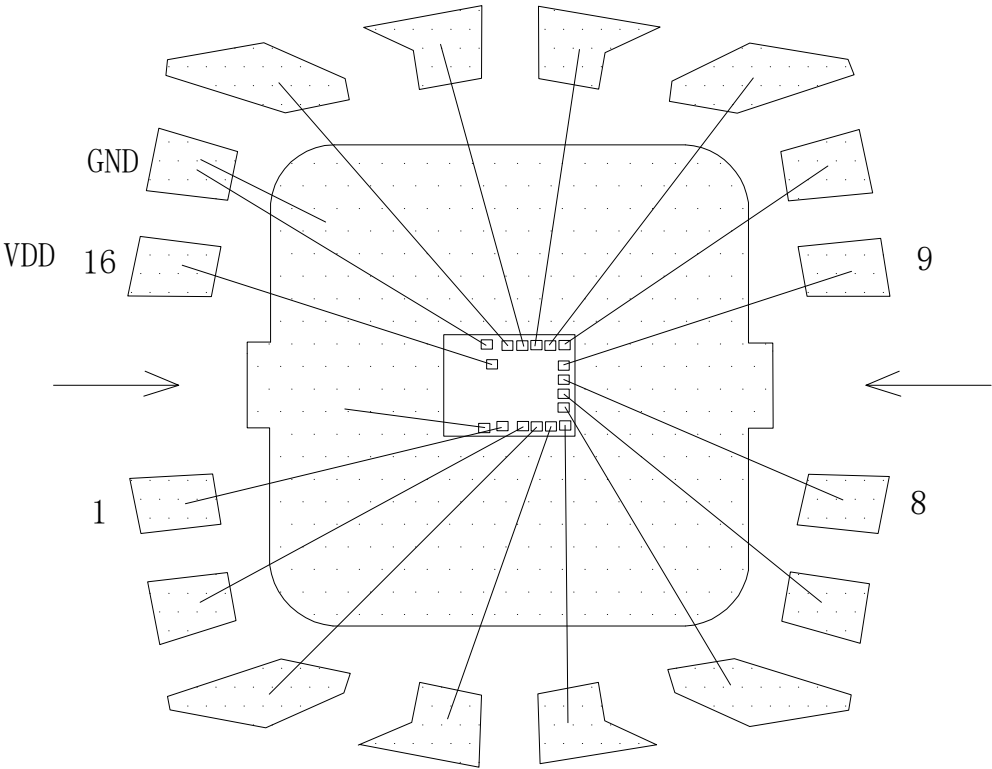


江苏芯丰集成电路封装压焊图		图号:314BD001	版本	A. 1
贴片方向（芯片与片环方向示意图） 	框架传输进料方向 第一个孔为椭圆孔 	芯片太小，更换基岛尺寸	2023. 2. 3	
		备注及特殊要求（Remark&Special Instruction） ↓ 代表流道方向 框架到芯片最高点的线弧高度<550um 居中装片		



顶针		点胶方式		UV膜	/	风险监控:低风险			
单顶针	多顶针	点胶	画胶						
	NA	•	NA	蓝膜	√				
产品型号 (Product Type) :		HS2303-P		线材直径 (Wire Diameter) :		银合金线0.8mil	芯片减薄厚度 (Chip thinning thickness)		300±10um
芯片名称 (Die Name) :		HS5122		压焊点尺寸 (Pad Opening) :		50.35×50.35um	装片胶 (Epoxy)	首选	9246LB5(导电胶)
芯片尺寸: (Die Size) :		0.5548×0.4332mm		最小压焊间距 (Min Pitch) :		59.85um		备选	S610C(导电胶)
封装形式 (Package Type):		SOP16L(9.9×3.9×1.4 e=1.27)		先焊线 (Wire Bond Start):		PIN15	塑封料 (Molding Compound)	首选	EMC-GR710F GN
引线框 (Lead Frame) :		SOP16L(12R)(80×80)		焊线总数 (Quantity of Wire) :		18		备选	/
L/F电镀方式 (L/F Plating Type):		雾 锡		最长线长(Length of longest Wire):		1.6mm	CUP/BOAC		<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
晶圆尺寸 (Wafer Size) :		/		顶层铝厚 (Top Al Thickness):		1um(3层)	RF 芯片		<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO
吸嘴 (suction nozzle)		RR10×10		切割道 (Cutting Way)		60um	LOW-K芯片		<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO
拟制 Prepared by		薛晶晶 2023. 2. 3		审核 Checked by			批准 Approved by		